ETCHING END POINT JUDGING METHOD

Patent number:

JP61053728

Publication date:

1986-03-17

Inventor:

KAWASAKI YOSHINAO

Applicant:

HITACHI LTD

Classification:

- international:

H01L21/302

- european:

Application number:

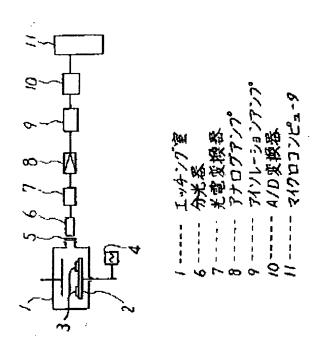
JP19840174934 19840824

Priority number(s):

Abstract of JP61053728

PURPOSE:To obtain accurate secondary differential value of light emitting intensisty and judge the end point of high precision etching by monitoring light emitting intensity of plasma in the particular wavelength and eliminating noise element of light emitting intensity by digital operation processing.

CONSTITUTION: A water 3 is placed on a lower electrode 2 within an etching chamber 1, the etching gas is supplied and plasma discharge is generated by applying a high frequency signal from a high frequency signal generator 4. Only the particular wavelength is extracted with a spectrometer 6 from the spectrum of such plasma and the particular wavelength is converted into a voltage with an optoelectro converter 7. This voltage is amplifier to a predetermined value with an analog amplifier 8, an output thereof is applied to an A/D converter 10 through an isolation amplifier 9 and the light emitting intensity of particular waveform is converted to a digital value and is then applied to a microcomputer 11. The secondary differentiation values are obtained from the moving averages of sampling values of light emitting intensity of particular wavelength and moreover the moving averages of these values are compared with preset values in order to judge the end point of etching.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

φ » # • # · •

(54) ETCHING END POINT JUDGING METHOD

(11) 61-53728 (A)

(43) 17.3.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 59-174934

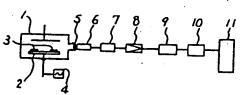
(22) 24.8.1984

(71) HITACHI LTD (72) YOSHINAO KAWASAKI

(51) Int. Cl. H01L21/302

PURPOSE: To obtain accurate secondary differential value of light emitting intensisty and judge the end point of high precision etching by monitoring light emitting intensity of plasma in the particular wavelength and eliminating noise element of light emitting intensity by digital operation processing.

CONSTITUTION: A water 3 is placed on a lower electrode 2 within an etching chamber 1, the etching gas is supplied and plasma discharge is generated by applying a high frequency signal from a high frequency signal generator 4. Only the particular wavelength is extracted with a spectrometer 6 from the spectrum of such plasma and the particular wavelength is converted into a voltage with an optoelectro converter 7. This voltage is amplifier to a predetermined value with an analog amplifier 8, an output thereof is applied to an A/D converter 10 through an isolation amplifier 9 and the light emitting intensity of particular waveform is converted to a digital value and is then applied to a microcomputer 11. The secondary differentiation values are obtained from the moving averages of sampling values of light emitting intensity of particular wavelength and moreover the moving averages of these values are compared with preset values in order to judge the end point of etching.



BEST AVAILABLE COPY

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭61-53728

(a) Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986)3月17日

H 01 L 21/302

E-8223-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

エッチング終点判定方法

②特 願 昭59-174934

❷出 願 昭59(1984)8月24日

70発 明 者 川 崎

韓 宿

下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠戸工場

内

⑪出 顋 人 一株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外1名

明 加 如

発明の名称 エッテングの終点制定方法 特許約求の韓國

1. 発光分光法を用いたドライエッテングの件点 利定技量において、特定该長の発光性反をデッ タルに変換してサンプリングし、当該サンングは の1次数分性を求め、当該1次級分値の移動平 均値の差分によりサンプリング値の2次数分値 を求め、まらにこれらを移動平均した値を予め 技定した低と比較することにより、エッテング の件点利度方法。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は、エッテングの終点判定方法に係り、 プラズマ故電光の分光強度波形を得てエッテング 終点を計算処理にて設出するエッテングの終点判 定方法に関するものである。

(発明の背景)

エッテングの終点を自動的に判定する方式として、従来より、被エッテング誘題や、エッテング ガス圏に応じて、特定の被長の発売強度のを到定 して行う発売分売独が広く用いられている。

発光強度を得て、エッテングの終点を判定する方法としては、例えば、特別昭38-31503 0 号会報に記載のような、エッテング前の発光強度を配慮しておき、各時刻での発光強度を比較して、この値が、記憶してある初期値に関った時を作点とする方式や、例えば、特別昭58-216423号会機に記載のような、発光独皮の差分、即ち勾配が所定値以下となる点を終点とする方式等が知られている。

実際の発光強便の放形には、電源リップルの50~60Hzから数MHzに至る各種の接き成分を含んでいるため、運断用波数の衝めて低いローバスフィルタを用いたり、発光な度のサンプリング値を、一定時間内では物平均する方法や、サンプリング回開を10~20秒位に、比較的長くとり、残合に対する影響を少くする方法が保用されても

特開昭61-53728(2)

た。しかし、これらの方法は、いずれも、正確な ェッテングの終点に対して時間的なずれが大きく、 斉枋収な終点判定が困難であるという問題を含ん

(報明の目的)

本発明の目的は、発光強度の難音成分をデジタ ル波な処理によって攻除る。発光強度の2次数分 位を正確に得て、精度の良いエッテングの終点判 定を行うことができるエッチングの終点判定方法 を提供することにある。

(発明の概要)

本景明は、終点後出の精度を上げるため、発売 **強度のサンプリング周期をデジタル浪算処理装置** の能力の許す範囲で、低力抵かくし。サンプリン グ故を歩くするとともに、これらを、サンプリン グ時間毎に移動させながら平均した値、即ち、移 動平均値を新らたなサンプリング値とすることに より、実務性の推合成分を取除す、これらの移動 平均サンプリング値から求めた1次微分値(勾配) をさらに移動平均し、これらの楚分を求め、その

楚分値のさらに移動平均値を以って、発光拡灰の 2 次徴分値を求めることにより、エッテングの枠 点を特皮良く独出できるようにしたものである。 (発明の実施器)

節1回は、本元明に係るエッテング許点判定数 異の構成を示したものである。

エッテング賞1内には、下部電面3上にウェハ 3 が設置され、エッテングガスを導入して、下部 低価2に高局被発掘数4により高周波を印加する ことにより、プラズマ放電を超こす。エッテング 宝1には、ブラズマ発光を取り込むための、のぞ ま思るが投けられており、これを通過するプラズ マの発光スペクトルから、分光器もにより、特定 の被長のみを取り出す。この特定被長の発光強度 は光電変換器でを通して電圧に変換し、これをア ナログアンプもにより所定値に増順する。ここで、 外部からのノイズや、発光強度に含まれる高風波 ノイズを神間的遅れなく取除しため、アイソレー ションアンプ9を介してA/D変換器ISに導入し、 特定波長の発光強圧をデロタル化してマイクロコ

ンピューナルに取り込む。毎2回は、このように して、マイクロコンピュータ11に取り込まれたサ ンプリング値の1例を示すものである。

今、対烈なにおけるサンプリング値を51とする 時、mを任立の勇敢として、

Y; [81-m/1+81+m/1+2 (81-m/1+1+81-m/1+1 +81-m/1+1+---+ \$1-m/1+(m-1) })/(2·m) --(1)

により、サンプリング値Siの移動平均値Yiも求め る。したがって、Yiはサンプラングを開始して型 假を越えた時刻からサンプリング時間 凸し号に形 に得られることになる。

(1)式でおられた刻々のYiから、8iの勾配 2)を 臼式により求める。

$$Z_k = (Y_1 - Y_1 - \iota) / \Delta \iota$$
 [3]

但し j≥2. k=1, 2, 3

次に(3)式で得られた超々の勾配ではも(5)式により B 助平均してVkを求める。

Ve = (Zk-m/++Zk+m/++ (Zk-m/+-1+Zk-m/++

+ ····· + Zh-m/1+(m-1) }) / (2 · m) ·····(5) 但し j≥m+1, k=1, 2, 3, … a …… (6) 次に超々舟られる Vaより (7)式を用いて Ve 即 ちャンプリング位Siの2次数分値を求める。

..... (7) $U_{\theta} = (V_{\ell} - V_{\ell-1}) / \triangle t$ P = 1 , 2 , 3 , (8) ただし ピネ2 まらにUoの雑音成分を取除しため、これらの符 助平均をWeを(9)式により求める。

Wa = (Up-m/1+) (Up-m/1+1+Up-m/1+1+ +U₂-m/2+(m-1) })/(2 · m) {9}

但し P m / 2+1. p=1, 2, 3, ----00 (9)式で得られるWeは、骨光強度のサンプリグ値 SIの2次数分値を与えるものである。SIにより、 時々刻々に計算される Yi. Zk. Vg. Up. W。の例刻 風についてある団に示す。

このように、サンプリング明始後、(3m+2) ・△1後より、△1 毎に、発光独皮の2充数分値 Weが得られることになる。

預問 61-53728 (3)

第4回から38回は、上述の手法を用いて、m=12の場合についてマイクロコンピュータによりシミュレーションした結果したものである。

第4回は、終点付近の発光強度のサンプリング 値のシミュレート値である。

第5回は、上記別を移動平均したもので、サンプリング値のランダムな乱れが、まれいに取除かれていることがわかる。

第6回は、移動平均した51の1次数分値を示し 第7回は、Veより求めた移動平均前の2次数分値 Uoである。この状態では、まだかなりの波形の乱 れが見られる。258回はUoをさらに移動平均した ものであり、理想的な波形が得られていることが わかる。

上述のシミュレーション結果からも明らかなように、第4回で示すような、推合を含む骨光減度のサンプリング値から、照8回に示すような、推 者成分のないまれいなま次数分値が得られることがわかる。

これにより、片点判定位又又はYの比較を行う

ことにより、A点又はB点において、抽収良く将 点を概定することができる。

上述の例は、比較的雑音成分の多い場合について述べたが、エッテングガスや被エッテング膜によっては、比較的雑音成分の少ない発売スペクトルを出すものもあり、このような場合には、移動平均を行う前の2次数分値Upまでを求め、これにより終点初度を行うことも可能である。

この場合には、サンプリング開始後(2m+2)・ Δ 1 後より、 Δ 1 毎に U_p が得られ、 $m\cdot\Delta$ 1 だけ早く終点制定が可能となる利点がある。

また逆に対合成分が衝域に多い場合には、第1 回において、リニヤアンプ 8 とアイソレーレ 8 ン アンプ 9 との間に、比較的遮断局被性の高いロー パスフォルターを挿入することにより、時間遅れ の少ない高指度の終点制定が可能となる。

(発明の効果)

以上述べたように、本発明によれば、プラズッ 発光の特定技長の発光協定をキニタして、エッテ ング の終点を検出する場合、サンプリング周別を

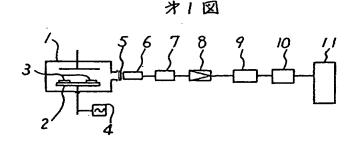
短かしして、サンブル歌を増やし、それらが発音によって大きく乱れていても、 環想的な発光強度の 2 次数分位が得られるので、発光強度が下がり始める所、あるいは、下がりきる 医前でエッテングが終点となる被エッテング膜の終点を確実に判定することができる効果がある。

図面の簡単な説明

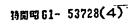
第1回は、本分明を実施した禁証の一例を示す ブロック図、第2回は、第1回の検証による発光 独皮のサンプリング例、第3回は、各計算値の時 刻型、面4回から第8回は、コンピュータによる シミュレーション結果をおのおの示す。

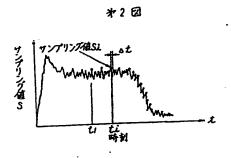
1 ····· エッテング宮、6 ····· 分元替、7 ···· 元 電双換器、6 ····· アナログアンプ、9 ···· アイソ レーションアンプ、10 ····· A/D変換器、11 ····· マイクロコンピュータ

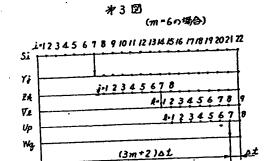
代型人 弁型士 西 森 帆



1---- エッチング室 6---- 分光器 7---- 光電変換器 8---- アナログアンプ 9---- アイソレーションアンプ 10---- A/D変換器 11---- マイクロコンピュータ







時刻

